

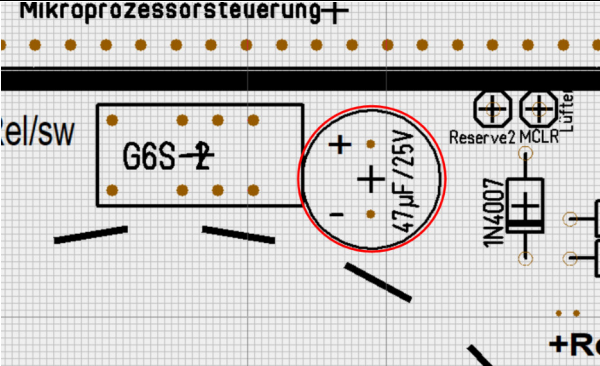
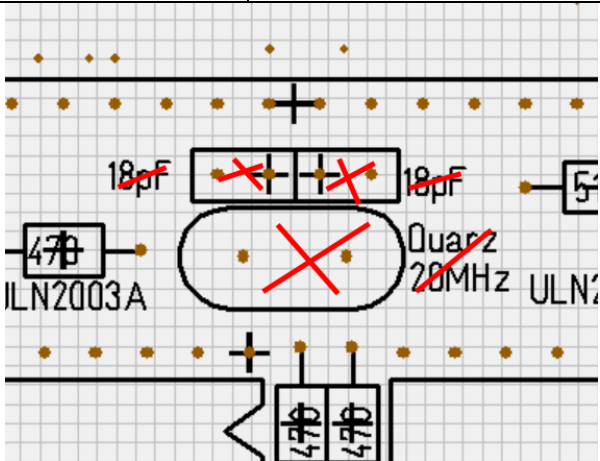


Hinweise zur Bestückung der Platinen RoeTest V10.4R2: [remarks assembling V10.4R2](#)

	
<p><b>Hauptplatine</b></p> <p>Beim Bestückungsdruck ist nicht erkennbar welcher Anschluss des 47 µF Elkos Plus ist. Deshalb ergänzend folgender Bestückungsplan (Elko neben dem Hilfstrafo):</p>	<p><b>Mainboard</b></p> <p>With the assembly print it is not clear which connection of the 47 µF Elko Plus is. Therefore, the following supplementary assembly plan (Elko next to the auxiliary transformer):</p>
	
<p><b>Prozessorplatine</b></p> <p>Ab Firmware V10.5 wird ein neuer Prozessor mit internem Takt (64 Mhz) verwendet. Die externe Beschaltung mit dem Quarz 20 MHz und die beiden Kondensatoren mit 18pF können entfallen</p>	<p><b>Processor board</b></p> <p>From firmware V10.5, a new processor with an internal clock (64 Mhz) is used. The external wiring with the 20 MHz crystal and the two 18pF capacitors can be omitted</p>
	
<p><b>G1 und G3 Karte:</b></p> <p>Anstelle der 20 Ohm Spindeltrimmer verwenden Sie 10 Ohm Spindeltrimmer (20 Ohm sind bei Reichelt derzeit nicht erhältlich).</p>	<p><b>G1 and G3 card:</b></p> <p>Instead of the 20 ohm spindle trimmer, use 10 ohm spindle trimmer (20 ohms are currently not available from Reichelt)</p>